

# 2026 高雄盃機器人挑戰賽—科技寶經典賽

## TEMI 積體電路應用技藝技能競賽(001~002組)

### 積體電路應用—電子元件拆與鉚專業級競賽 競賽規則

DATE: 20260511

#### 壹、競賽說明

- 一、本項競賽的能力訴求主要以評量參賽選手對於電路板上零組元件的拆鉚能力及微控制器功能驗證,其中包括表面粘著元件拆鉚、插件式元件拆鉚,拆鉚測試板操作等能力。
- 二、競賽方式,依 TEMI「電子元件拆與鉚專業級能力認證」術科試題實施,內容請參考電子元件拆與鉚專業級術科測驗參考資料。
- 三、賽程所使用的測試板屬於主辦單位所有,參賽選手必須在完成競賽評分後全數歸還給主辦單位。
- 四、若不符合以上規定,則喪失參賽權,且不得提出疑義。

#### 貳、參賽資格

- 一、參賽隊伍需由 1 位選手組成,並參賽。
- 二、參賽隊伍為在校生者,則每隊需要 0~3 位指導老師,指導老師可同時指導多組隊伍。
- 三、全國高中職校(或五專部一至三年級)、大專院校生之在校學生均可參與。

#### 參、競賽流程

選手報到→各組代表抽籤→賽程進行→完工(或淘汰)→優勝隊伍產出→競賽完成

梯次	時間	時數	說明
上午場次 (下午場次)	指定時間	15 分鐘	報到
	指定時間	15 分鐘	宣佈競賽規則、抽籤、拆鉚測試板檢驗
	指定時間	150 分鐘	電子元件拆與鉚競賽(專業級) 1. 實施拆鉚成品板電路元件拆鉚、微控制器功能驗證、拆鉚成品板元件鉚接作業 2. 依照作業規則進行整體評分
成績公佈	指定時間		依競賽當日 大會公告時間為主

比賽時間如有異動時,以大會競賽報告為準

#### 肆、競賽規則

參賽選手必須依照 TEMI「電子元件拆與銲專業級能力認證」術科試題之電路圖及元件佈置圖，將所有零組元件逐一進行拆卸與銲接作業，最後再針對成品進行功能測試的操作與評分。

#### 伍、競賽方式

- 一、每隊參與競賽之選手，需自行攜帶下列物品：
  - (一)請參賽者自備競賽套件(術科材料包)。
  - (二)Micro USB 傳輸線+充電插座。
  - (三)手工具組(烙鐵、烙鐵架、錫絲、助銲膏油、吸錫器、SMD 鑷子、三用電表、熱風槍等。(請勿使用錫爐或電動吸錫器等類型設備工具)。
  - (四)延長線(線長 2 米以上)。
  - (五)4 號電池(AAA 電池;至少 4 個，用於功能測試使用)
- 二、每隊參與競賽之選手於報到後，進行各組代表抽籤，決定競賽崗位。
- 三、競賽時間最長 150 分鐘，參賽選手完工後，即可舉手向裁判提出競賽評分要求。提出競賽評分要求時，必須完成崗位環境整理並同時繳交成品、競賽評分表。
- 四、測試板功能測試操作需由參賽選手自行操作，不得要求裁判或旁人協助，違者取消資格。
- 五、參賽選手應自行檢查崗位桌面上是否有裁判簽名的銲接電路板，以及競賽所需的材料、設備、測試板，如有任何問題應在指定時間之前完成替換或補充作業，在規定時間之後提出者均需依規定予以扣分。
- 六、參賽選手必須在指定時間依規定完成競賽指定工作，並請裁判確認檢查後在競賽評分表上簽名，未能於時間內完成者將以淘汰論處。
- 七、因拆除或銲接不當造成微控制器損壞而需更換者，依規定扣除 20 分，若需二次更換者，將以淘汰論處。
- 八、凡經裁判判斷或有直接具體事證顯示參賽選手故意損壞公物、儀器或設備者，除應負賠償責任之外，一律取消該次參賽資格。
- 九、參賽選手在完成競賽指定工作後，應對所使用之環境和桌面進行適當的整理清潔工作，否則視情節輕重由裁判決定扣分多寡，最高扣減分數可達 20 分。

## 陸、成績計算

### 完賽總分=術科成績+完賽加權分

- ✓ 術科成績：第一~三名，須達 80 分(含)以上；佳作，須達 70 分(含)以上
- ✓ 完賽加權分：根據完工時間為準，參照下表。

完賽加權分	電子元件拆與鉚專業級競賽 完賽加權分 總競賽時間：150 分鐘	
	大專校院組	高中職(五專部)組
10	45 分(含)以內	1 小時(含)以內
8	45 分(不含)~ 1 小時(含)	1 小時(不含)~1 小時 15 分(含)
5	1 小時(不含)~1 小時 15 分(含)	1 小時 15 分(不含)~1 小時 30 分(含)
2	1 小時 15 分(不含)~1 小時 45 分(含)	1 小時 30 分(不含)~2 小時(含)
0	1 小時 45 分(不含) 以上	2 小時(不含) 以上
完賽總分=術科成績+完賽加權分		

## 柒、獎勵方式

- 一、根據完賽總分由高至低排列次序，遇總積分相同者，比術科成績（較高優先排序），術科成績相同者，則比完工時間（較短優先排序）。
- 二、競賽獲獎名單於 2026 年 9 月 19 日(星期六)於國立高雄大學 活動中心公告。

## 捌、注意事項：

- 一、競賽當天場地的燈光明照、與環境的溫濕度均與一般的室內環境相同，參賽隊伍不得要求調整燈光的明暗、溫濕度等。
- 二、所有參賽者參與之競賽場地皆相同，參賽者不得抗議競賽場地或要求變更坐位。
- 三、主辦單位保留酌減得獎隊伍名額之權力。
- 四、參賽選手舉手評分時，作品和成績一經裁判評定後不得要求更改；若有疑問或異議者，可由帶隊指導老師向主辦單位提出質疑，主辦單位將做相關之說明，但最後之裁決，仍依主辦單位(裁判團)之決定。
- 五、參賽選手不得攜帶或夾帶任何非主辦單位所提供之儲存設備(工具)、圖說、材料、元件和其它檔案資料入場，一經發現即視為棄賽，並以淘汰論處。
- 六、參賽選手不得將試場內之任何器材及資料等携出場外，否則以淘汰論處。
- 七、參賽選手不得接受他人協助或協助他人，如經發現則視為棄賽，雙方皆以淘汰論處。
- 八、參賽選手於競賽進行中，應遵守競賽場內外秩序，禁止吸煙、窺視、嬉戲、喧嘩或交談。
- 九、參賽選手於競賽進行中，若因急迫需要上洗手間，須事先取得裁判同意，並由裁判指派專人陪往；參賽選手不得要求增加或延長競賽時間。
- 十、參賽選手在競賽期間未經裁判允許私自離開試場，或雖經允許但無特殊理由離場逾 15 分鐘不歸者，以棄賽（淘汰）論處。
- 十一、參賽選手競賽時，不得要求裁判公佈或告知競賽成績。
- 十二、通電檢驗測試時，若發生電路短路現象而造成損壞，例如：電池組、電子零件、IC 或印刷電路板綫路燒毀損壞等，應即停止工作不得重修，并以淘汰論處。
- 十三、競賽過程中，如要求更換零件，必須以損壞的的元件交換，每次更換均需列入扣分。
- 十四、如有其它規定事項或相關說明，另於競賽場地做補充。
- 十五、如有突發事項或未盡事宜，則可由裁判團（主辦單位）討論決議後，現場公佈執行。

十六、主辦單位均有權利進行當事者之拍照、錄影及在各式媒體上使用之權利，各隊不得異議。(不用預先告知)

十七、參賽者需詳閱并確實遵守所有競賽規則，各競賽項目詳細競賽規則、參考資料等。

十八、單一組別參賽隊數，於報名或實際現場出席隊數，沒有達8隊(含)以上時，經大會評估後，將同一類不同組，直接合并同一組競賽賽程，或隊數過多時，大會亦有保有再分組競賽賽程調整之權利並不再通知參賽隊伍。

十九、本競賽規則，活動單位保有修改之權利，請以活動官網公告或當日賽程公布為準，恕不另行通知。

#### 玖、獎勵方式

依『2026 高雄盃機器人挑戰賽-科技寶經典賽-TEMI 積體電路應用技藝技能競賽總則』規定執行。

#### 壹拾、聯絡窗口

台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會(TEMI)

聯絡人：黃勝源秘書長、李思萱專員

專線電話：02-22239560 / 02-82275565

E-MAIL: aleeb@etimag.com.tw

地址：23558 新北市中和區中山路二段419號6樓

#### 壹拾壹、競賽報名

<https://www.tirtpointsrace.org/>

#### 壹拾貳、活動網址

項次	名稱	網址	QR CODE
1	TIRT 競賽官網	<a href="https://www.tirtpointsrace.org/">https://www.tirtpointsrace.org/</a>	
2	TEMI 官網	<a href="https://www.temi.org.tw/news/view/385/">https://www.temi.org.tw/news/view/385/</a>	
3	TEMI 社團	<a href="https://www.facebook.com/groups/temitw/">https://www.facebook.com/groups/temitw/</a>	
4	TEMI 鈦米知識力頻道社群(LINE)	<a href="https://line.me/ti/g2/cTQ9NMiVhnuT9CELNdFokeRqcdI8QhcAWmHL3A?utm_source=invitation&amp;utm_medium=link_copy&amp;utm_campaign=default">https://line.me/ti/g2/cTQ9NMiVhnuT9CELNdFokeRqcdI8QhcAWmHL3A?utm_source=invitation&amp;utm_medium=link_copy&amp;utm_campaign=default</a>	
5	競賽宣傳影片	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=RE_--5GKA5Q">https://www.youtube.com/watch?v=RE_--5GKA5Q</a>	

2026 高雄盃機器人挑戰賽—科技寶經典賽 TEMI 積體電路應用技藝技能競賽

積體電路應用—電子元件拆與鉅【專業級】競賽 評分表

姓名	參賽學校	組別	<input type="checkbox"/> 高中職 (五專部)	評審結果	<input type="checkbox"/> 及格	
參賽日期	年 月 日	崗位號碼	<input type="checkbox"/> 大專校院		<input type="checkbox"/> 不及格	
不予評分項目				*有左列事項之一者不予評分，並請考生在本欄位簽名。		
一	提前棄權離場者					
二	未能於規定時間內完成者					
三	依據應試須知八注意事項之第____條規定以不及格論					
四	其它突發或特殊事項者(請註明原因_____)			離場時間：__時__分		
項目	評分標準	扣分標準			實扣分數	備註
		每處扣分	最高扣分	本項扣分		
拆鉅成品板電路 拆鉅評分	1. EM78P451 QFP 44PIN IC 因拆除不當造成損壞而更換或功能測試不正常者	20	20		(最多扣20分)	
	2. 完成拆除拆鉅電路板上所有零件	監評確認				
拆鉅成品板電路 鉅接評分	1. 違反術科認證動作要求七第二項功能動作不正常者	50	50		50分	(最多扣50分)
	2. 違反作業規則一 銅箔、鉅點(每處)	5	20		分)	(最多扣50分)
	3. 違反作業規則二 零組元件擺放、鉅接(每處)	5	20			
	4. 因鉅接不當造成零件之損壞或遺失而更換者(每顆)	10	50			
	5. 因鉅接不當造成 EM78P451 IC 損壞而更換者	20	20			
工作安全 與習慣	1. 不符合工作安全要求者(毀損設備或公用器材)	20	20		(最多扣20分)	
	2. 工作桌面凌亂或離場前未清理工作崗位者	20	20			
	3. 自備工具未攜帶而須向考場借用者	5	10			
	4. 未歸還模組機構、工作崗位工具短缺或毀損者	10	20			
	5. 逾時未提出設備故障更換者	10	10			
累計總扣分						
術科測驗總成績						
監評(一) 簽章		監評(二) 簽章		主監評 簽章		

提出評分時間(實際完工時間)：\_\_時\_\_分起至\_\_時\_\_分，總共\_\_時\_\_分

完賽加權分	電子元件拆與鉅專業級競賽 完賽加權分 總競賽時間：150分鐘		
	大專校院組	高中職(五專部)組	說明
<input type="checkbox"/> 10	45分(含)以內	1小時(含)以內	【大專校院組】、【高中職(五專部)組】 術科成績：分數皆為以上(含) 第一名~第三名，須達80分 佳作，須達70分
<input type="checkbox"/> 8	45分(不含)~1小時(含)	1小時(不含)~1小時15分(含)	
<input type="checkbox"/> 5	1小時(不含)~1小時15分(含)	1小時15分(不含)~1小時30分(含)	
<input type="checkbox"/> 2	1小時15分(不含)~1小時45分(含)	1小時30分(不含)~2小時(含)	
<input type="checkbox"/> 0	1小時45分(不含)以上	2小時(不含)以上	
完賽總分=術科成績+完賽加權分			